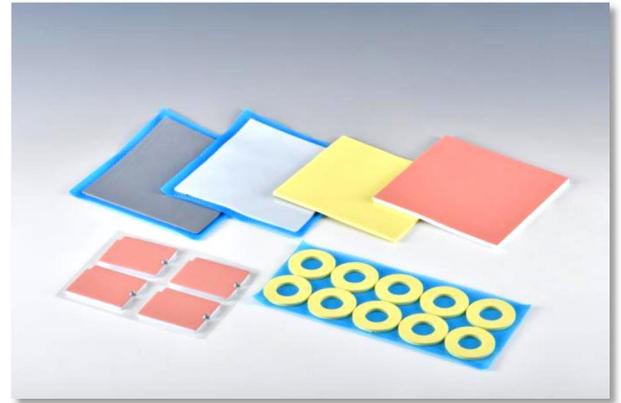


# 无硅导热垫片

## ● 产品描述：

**无硅导热垫片** 是特殊树脂为基材的非硅导热材料，添加金属氧化物与特殊助剂，通过特殊工艺处理的界面导热材料。无硅油析出或硅氧烷挥发，针对不同应用场合开发多个型号。



## ● 产品特点：

- 1) 良好的双面自粘性
- 2) 高绝缘、高耐温性
- 3) 低挥发、低出油

## ● 应用领域：

- ✓ 光模块
- ✓ 电源
- ✓ 通讯设备
- ✓ LED设备

## ● 使用方法：

- ❖ 在导热垫片可根据客户要求裁切或冲切为相应规格尺寸。使用酒精等溶剂清洁接触面，将垫片贴覆于发热界面或散热界面上，并尽量避免气泡产生。

## 无硅导热垫片

## ● 典型性能参数:

参数	单位	TPad-1200SF	TPad-1300SF	TPad-1600SF	TPad-1800SF
颜色	---	黄色	蓝色	灰色	灰色
密度	g/cm <sup>3</sup>	2.7	3.0	3.2	3.4
硬度	Shore OO	55	55	60	60
体积电阻	Ω·cm	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>9</sup>	10 <sup>9</sup>
导热系数	W/m·k	1.5	1.5	2.0	3.0
击穿电压	KV/mm ac	2.0	3.0	6.0	8.0
热阻抗@1mm	°C·in <sup>2</sup> /W	0.75	0.33	0.22	0.13
出油率	%	2.5	2.0	1.5	1.0
挥发分	%	0.5	0.3	0.1	0.1
阻燃等级	---	V0	V0	V0	V0
保质期	Month	12			

## ● 包装方式:

标准尺寸 200\*400mm/pcs 或 300\*400mm/pcs,

厚度 0.5~10mm, 纸箱包装。

## ● 存储条件:

室温避光保存, 湿度 < 75%